

\*\*\*\*\*

“AUTOMOTIVE WORLD 2019”

## 第 11 届 日本国际汽车电子技术展 参展

敬请莅临我司展位

\*\*\*\*\*

各位

承蒙关照，深表感谢。

恭祝贵司事业蒸蒸日上，一帆风顺！

此次我司参展“第 11 届 日本国际汽车电子技术展”，敬请各位莅临参观我司展位。

我司将会展出「高耐热・高信赖性环氧 大功率半导体模块用灌封树脂」、「减震・高耐热聚氨酯凝胶 聚氨酯凝胶灌封树脂」、「热传导性灌封树脂」、「功能性单组分胶水」、「朋诺灌封树脂的使用例 EV 汽车以及 HEV 汽车の假设配件方案」，期待您的到来。

需要入场邀请券，或希望详细商谈的贵宾请与我司销售部门联系或访问我司官网点击“联系我们”。

衷心的期待您的到来。

谢谢！

日期： 2019 年 1 月 16 日（星期三） - 18 日（星期五）10 点至 18 点  
18 日 17 点为止

会场： 日本 东京有名国际展览中心 (Tokyo Big Sight, Japan)  
东 4 ~ 6 号馆 “E46-14”

出展商： 朋诺株式会社 (Pelnox, Ltd.)